

臺灣桃園地方法院民事判決

108年度訴字第1175號

原告

即反訴被告 展翊光電股份有限公司

法定代理人 陳家慶

被告

即反訴原告 芯世界科技有限公司

法定代理人 呂志遠

訴訟代理人 范瑋峻律師

上列當事人間請求給付代工款事件，本院於民國111年2月23日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告應給付原告新臺幣壹佰伍拾玖萬陸仟伍佰貳拾伍元及自民國一〇八年三月六日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

本訴訴訟費用由被告負擔。

本判決第一項於原告以新臺幣伍拾參萬貳仟壹佰柒拾伍元供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣壹佰伍拾玖萬陸仟伍佰貳拾伍元為原告預供擔保，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

反訴原告之反訴及假執行之聲請均駁回。

反訴訴訟費用由反訴原告負擔。

事實及理由

甲、程序部分：

壹、按法定代理人之代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止；承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明；聲明承受訴訟，應提出書狀於受訴法院，民事訴訟法第170條、第175條第1項

01 、第176 條分別定有明文。本件原告起訴時之法定代理人為
02 廖永吉，嗣變更為陳家慶，並於109年7月6日具狀聲明承受
03 訴訟，揆諸前揭說明，核無不合，應予准許。

04 貳、按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告
05 及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如
06 專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連
07 者，不得提起，民事訴訟法第259 條、第260 條第1 項分別
08 定有明文。所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽
09 連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係
10 兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法
11 所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴
12 標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴
13 標的之法律關係同一，或當事人雙方所主張之權利，由同一
14 法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴
15 標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者
16 間有牽連關係，最高法院70年度台抗字第522 號裁定意旨可
17 資參照。查本件原告即反訴被告（以下除「貳、兩造反訴之
18 主張及答辯」部分稱反訴被告外，均統稱原告）對被告即反
19 訴原告（以下除「貳、兩造反訴之主張及答辯」部分稱反訴
20 原告外，均統稱被告）起訴請求給付代工款新臺幣（以下未
21 註明幣別者均同）159 萬6,525 元，被告則於言詞辯論終結
22 前提起反訴，請求原告給付因承攬標的物之瑕疵導致其遭多
23 家下游廠商求償所生損害人民幣141 萬元，核本件反訴與本
24 訴均係針對被告委託原告代工製造電子零配件之瑕疵所生爭
25 議，堪認反訴之標的與本訴之標的間，在法律上或事實上均
26 關係密切，審判資料有共通性、牽連性，復無其他民事訴訟
27 法第260 條所定不得提起反訴之情形，是被告提起本件反
28 訴，自應准許。

29 乙、實體部分：

30 壹、兩造本訴之主張及答辯：

31 一、原告主張：

01 (一) 兩造於民國107 年6 月15日簽訂OEM Cooperation Agreem
02 ent (下稱系爭107 年6 月15日協議)，約定由被告委託
03 原告代工製造「品名：Chip (按：即晶片，大陸地區譯為
04 芯片)，規格：2.5G 1310nm/1550nm FP LD、數量：100P
05 C，價格：2 萬8,500 元/PC」(就上開規格為1310nm之
06 晶片，下稱系爭甲晶片；就上開規格為1550nm之晶片，下
07 稱系爭乙晶片)及「品名：Chip，規格：2.5G 1310nm DF
08 B LD，數量：15 SET，價格：4 萬3,500 元/SET」等零
09 件，並由被告以國內訂單、訂單變更單(客戶單號為COZO
10 0000000000號、訂單單號為00000000000 號，下稱系爭訂
11 單)，委託原告代工製造系爭甲晶片24片及系爭乙晶片26
12 片，合計含稅價額為150 萬3,600 元，原告並如期將系爭
13 甲晶片24片、系爭乙晶片17片交付被告，且通知被告受領
14 其餘系爭乙晶片9 片，然被告並未依約給付價金，經原告
15 催討，均未獲置理。

16 (二) 被告復於107 年8 月20日與原告簽定編號為LZ0000000000
17 之合同(下稱系爭合同)，委由原告進行電子零配件之鍍
18 膜、測試、切割及挑選，並約定就系爭甲晶片1 片進行鍍
19 膜；就規格為2.5G 1550nm DFB LD之零件1 片進行鍍膜、
20 測試、切割及挑選；就規格為2.5G 1650nm DFB LD之零件
21 1 片進行測試、切割及挑選，費用含稅分別為5 萬7,750
22 元、3 萬1,500 元、7 萬4,400 元。嗣原告已依約完成代
23 工，其中規格為2.5G 1650nm DFB LD之零件因未達良率，
24 經被告同意停止原製程，原告僅收取代工費用3,675 元，
25 是原告自得請求被告給付此部分代工費用9 萬2,925 元
26 (計算式：5 萬7,750 元+3 萬1,500 元+3,675 元=9
27 萬2,925 元)，惟經原告催討仍未果。

28 (三) 爰依民法第505 條、系爭107 年6 月15日協議及系爭合同
29 法律關係，請求被告給付159 萬6,525 元(計算式：150
30 萬3,600 元+9 萬2,925 元=159 萬6,525 元)等語。並
31 聲明：1. 被告應給付原告159 萬6,525 元，及自如附表一

01 所示利息起算日起至清償日止，依週年利率5 %計算之利
02 息。2. 願供擔保，請准宣告假執行。

03 二、被告則以：被告委託原告代工製造之上開產品，經原告交貨
04 後，被告即將之發送下游廠商進行老化加工，然於107 年7
05 月間起接獲大量下游廠商關於瑕疵之客訴，經被告測試後，
06 發現係因鍍膜製程有缺失，導致晶片脊邊緣處有凹陷、氧化
07 層有過刻超過表層所引起之鏡面損傷，數值介於150至200
08 間，低於應高於300之業界正常標準數據，且上開瑕疵已屬
09 無法補正之重大瑕疵，被告自得依民法第494 條規定，請求
10 減少承攬報酬至零；況且，原告既有瑕疵給付之事實，應負
11 債務不履行之不完全給付責任，被告亦得依民法第264 條第
12 1 項規定主張同時履行抗辯權而拒絕給付報酬等語，資為抗
13 辯。並聲明：(一)原告之訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔
14 保，請准宣告免予假執行。

15 貳、兩造反訴之主張及答辯：

16 一、反訴原告主張：兩造約定由反訴被告為反訴原告就晶片進行
17 後段加工後，反訴被告共製作96萬顆晶片，然反訴原告領取
18 部分成品後發送至下游廠商進行老化加工，惟接獲大量異常
19 之客訴，經測試後發現係因原告之鍍膜製程有缺失，導致上
20 述重大瑕疵，且上開產品之瑕疵亦可歸責於反訴被告，導致
21 反訴原告因產品瑕疵遭下游廠商追償人民幣141 萬元，而受
22 有損害，爰依民法第227 條第1 項準用第226 條、第492
23 條、第495條之規定，主張反訴被告應就系爭產品負承攬瑕
24 疵擔保責任，及債務不履行之不完全給付責任等語。並聲
25 明：(一)反訴被告應給付反訴原告人民幣141 萬元，及自反訴
26 起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5 %計算之
27 利息。(二)願供擔保，請准宣告假執行。

28 二、反訴被告則以：反訴原告並未舉證證明反訴被告代工之96萬
29 顆晶片均有瑕疵，遑論上開晶片製程繁複，實則在磊晶、黃
30 光製程、鍍膜及封裝等工序均有可能產生差錯，導致晶片出
31 現瑕疵，未必即係原告負責之鍍膜工序產生瑕疵；況且，被

01 告並未提出其遭下游廠商追償之單據資料，僅片面以自行製
02 作之供應商質量異常索賠單主張遭下游追償而受有損害，自
03 屬無據等語，資為抗辯。並聲明：(一)反訴原告之訴駁回。(二)
04 如受不利判決，願供擔保，請准宣告免予假執行。

05 參、本院之判斷：

06 一、本件原告依約應給付之內容為鍍膜及封裝測試：

07 查，觀諸兩造簽立之系爭107 年6 月15日協議，雖於「第3
08 條、委託製造加工內容」中僅記載：「主件：雷射芯片。乙
09 方（即原告）須遵照甲方（即被告）提供之製造作業及檢驗
10 標準加工製造之。乙方不得設計、製造或販賣近似甲方委託
11 加工之產品，既有產品不在此限。甲方技轉之設備、材料、
12 治工具、製程參數或手法，乙方須取得甲方同意後，方可使
13 用之。」，然依證人即原告之前總經理曾勝揚於本院審理時
14 證述：原告公司代工的項目基本上就是鍍膜跟封裝測試這一
15 塊，磊晶跟黃光製程都不是原告公司這邊執行的項目。磊晶
16 是大陸地區的全磊做的，黃光製程是臺灣的友嘉科技製造
17 的，原物料是被告公司提供等語（見本院卷二第262-263
18 頁），本院衡酌曾勝揚雖前為原告之總經理，然自離職後不
19 僅原告曾對曾勝揚提起背信罪之刑事告訴，曾勝揚亦對原告
20 提起侵害名譽權之侵權行為損害賠償訴訟，有臺灣桃園地方
21 檢察署108年度偵字第28365號不起訴處分書、民事起訴狀繕
22 本附卷可考（見本院卷一第395-406頁），可見曾勝揚與原
23 告已恩斷義絕，且曾勝揚既係被告聲請傳喚到庭作證，形式
24 上應係被告之友性證人，其證述內容偏袒原告之可能性應甚
25 低，是其證稱原告提供之加工服務僅有鍍膜及封裝測試，不
26 包括磊晶及黃光製程等節，應堪採信；而系爭107 年6 月15
27 日協議雖未明載原告僅提供鍍膜及封裝測試之服務，但衡諸
28 晶片工業製程繁複，完成一片晶片需要經過之工序可能達數
29 百道甚至數千道，而不同公司專精之工序不同，以晶片工藝
30 之精細亦無從濫竽充數，是被告應無可能不知原告僅可能就
31 其所精通之工序提供服務。從而，兩造雖未於系爭107 年6

01 月15日協議記載原告提供之加工服務僅有鍍膜及封裝測試，
02 但此仍應為兩造締結系爭107年6月15日協議時合意之內
03 容，而為原告給付義務之範圍，先予敘明。

04 二、被告未能舉證證明原告之給付有瑕疵或有不完全給付：

05 按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，
06 民事訴訟法第277條前段定有明文。本件被告抗辯原告提供
07 之鍍膜工序有瑕疵，違反承攬人之瑕疵擔保義務並有不完全
08 給付情事等節，既為原告以上揭情詞否認，揆諸前揭規定，
09 應由被告就上開有利於己之事實負舉證責任。查：

10 (一) 證人曾勝揚雖曾於本院109年6月10日言詞辯論期日證述：

11 我是國立中央大學光電研究所碩士，也是原告公司創始人
12 及董事，在任職期間我擔任公司總經理及廠長，原告公司
13 於107年間接獲被告投訴代工產品有質量異常情況後，內
14 部有召開會議，也有跟協力廠商確認，將所有上下游廠商
15 交叉比對完之後，認為原告公司鍍膜的工序高度可能是造
16 成異常的原因，這會導致晶片耐受度降低，壽命與可靠度
17 會差很多，這個瑕疵是無法修復的等語（見本院卷一第31
18 2-314頁），然其後於110年12月30日本院言詞辯論期日則
19 證述：反證4的107年10月18日分析報告是當時原告公司的
20 張博士跟游經理彙整的報告，因為造成異常的成因很多，
21 我們之後還要做進一步分析，這在報告裡也有寫。我前次
22 作證時說有高度可能性為原告公司鍍膜工序所造成，是依
23 照報告的內容陳述我個人意見等語（見本院卷二第262-26
24 4頁），與初次證述內容已明顯有異；再者，觀諸原告提
25 出其公司人員與被告公司人員往來之電子郵件紀錄（見本
26 院卷二第208-210頁），曾勝揚於107年11月12日仍為原告
27 公司總經理時，向被告公司之負責人呂志遠傳送電子郵件
28 表示：「這件事情wafer process分成兩段進行，先確認
29 新的wafer process工序可行性，才正式投入物料執行，
30 因此遲延約8-10 WDs，當然以wafer process代工廠的立
31 場，要求必須正規接單投料試產，又延遲2-3個工作天，

01 目前已依照要求執行，本周即可提供樣品，敝司也將同步
02 驗證，屆時有勞貴司提供他廠鍍膜樣品，讓敝司派員前往
03 確認封測驗證過程，我方同步場內驗證，以利雙方釐清真
04 因與討論責任歸屬，請知悉！」，可見於反證4之107年10
05 月18日分析報告作成後，曾勝揚在擔任原告公司總經理期
06 間與被告公司負責人書面往來時仍表示責任歸屬有待釐
07 清，何以離職後，於本院初次作證時能依照分析報告判斷
08 晶片異常高度可能為原告公司鍍膜工序造成？實令人不
09 解。足見證人曾勝揚對原告不利之證述憑信性甚低，不足
10 作為認定不利原告事實之依據。

11 (二) 另被告雖曾聲請就原告代工之晶片鑑定，以釐清責任歸
12 屬，然經本院函請財團法人中華工商研究院鑑定，並請兩
13 造會同以隨機方式自原告代工後交付被告之晶片中取樣5
14 片（如係不同規格晶片，每種規格各取樣5片），並陳報
15 到院以利鑑定，然兩造遲未會同陳報送鑑晶片，經本院詢
16 問被告，被告稱：原告出貨給被告的晶片都送加工了，因
17 此被告手上的晶片全部都是加工過的，原告說不要送這些
18 加工過的晶片去鑑定，所以變成無法鑑定，因為我們無法
19 提供原始的晶片等語（見本院卷二第72頁），足見本件亦
20 無法透過鑑定之調查方法釐清晶片異常之原因。又被告雖
21 抗辯原告內部之分析報告已承認晶片異常為原告代工之責
22 任，但觀107年10月18日分析報告（見本院卷一第208
23 頁），就結論部分僅稱「導致產品異常的主因是鏡面損傷
24 （COD）所致。造成COD主要原因：磊晶、黃光製程、鍍
25 膜、封裝。」，並未有隻言片語表示係原告負責提供之鍍
26 膜及封裝服務有瑕疵導致晶片異常，是被告上開抗辯，亦
27 非有據。

28 三、按報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成
29 時給付之；因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付
30 前，得拒絕自己之給付。但自己有先為給付之義務者，不在
31 此限，工作有瑕疵者，定作人得定相當期限，請求承攬人修

01 補之。如修補所需費用過鉅者，承攬人得拒絕修補，前項規
02 定，不適用之。承攬人不於前條第一項所定期限內修補瑕
03 疵，或依前條第三項之規定拒絕修補或其瑕疵不能修補者，
04 定作人得解除契約或請求減少報酬，民法第505條、第264條
05 第1項、第493條第1項、第3項、第494條定有明文。查，本
06 件原告已依約提供鍍膜、測試等代工服務並交付代工之晶
07 片，有銷貨單、發票、出貨單證明單據在卷可考（見臺灣臺
08 中地方法院訴字卷第26-61頁），而被告既無法舉證證明原
09 告提供之鍍膜工序有瑕疵，本院即難認原告有違反承攬人之
10 瑕疵擔保義務或有不完全給付情事，其自應依約給付承攬報
11 酬，是原告依民法第505條、系爭107年6月15日協議及系
12 爭合同法律關係，請求被告給付159萬6,525元，於法有
13 據，可以准許。

14 四、而就被告反訴請求原告賠償遭下游廠商追償人民幣141萬元
15 之損害部分，按因可歸責於承攬人之事由，致工作發生瑕疵
16 者，定作人除依前二條之規定，請求修補或解除契約，或請
17 求減少報酬外，並得請求損害賠償；因可歸責於債務人之事
18 由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不
19 能之規定行使其權利；因可歸責於債務人之事由，致給付不
20 能者，債權人得請求賠償損害，民法第495條第1項、第227
21 條第1項、第226條第1項定有明文。本件被告未能舉證證明
22 原告有違反承攬人之瑕疵擔保義務或有不完全給付情事，已
23 如前述，是其依上揭規定反訴請求原告賠償遭下游廠商追償
24 人民幣141萬元之損害，於法不合，不能准許。

25 五、未按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經
26 其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。遲延之債
27 務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之
28 遲延利息。應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可
29 據者，週年利率為百分之五，民法第229條第2項前段、第
30 233條第1項前段及第203條亦分別定有明文。而所謂無確
31 定期限，指未定期限（不定期債務）及雖定有期限而其屆至

01 之時期不確定（不確定期限之債務）二種情形。經查，本件
02 原告已依約提供鍍膜、測試等代工服務並交付代工之晶片，
03 惟其既未舉證證明兩造另有約定報酬給付日，則被告應為之
04 前開給付，自屬雖定有期限而其屆至之時期不確定之無確定
05 期限債務，從而，原告依據民法第505條、系爭107年6月
06 15日協議及系爭合同法律關係，請求被告給付159萬6,525
07 元，及自民事支付命令送達被告之翌日即108年3月6日（見
08 支付命令卷第132頁）起至清償日止，按週年利率5%計算
09 之利息，即屬有據，應予准許；逾此部分之利息請求，則非
10 有據，應予駁回。

11 肆、綜上所述，本訴部分，原告依民法第505條、系爭107年6
12 月15日協議及系爭合同法律關係，請求被告給付159萬6,52
13 5元，及自108年3月6日起至清償日止，按週年利率5%計
14 算之利息，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，則非有
15 據，不能准許；反訴部分，被告請求原告給付人民幣141萬
16 元及自反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率
17 5%計算之利息，為無理由，應予駁回。另兩造均陳明願供
18 擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，於法均核無不合，爰
19 就原告本訴勝訴部分酌定相當擔保金額分別准許之；至原告
20 本訴敗訴部分，及被告反訴之假執行聲請，因訴之駁回而失
21 所附麗，應併予駁回。

22 伍、本件事證已臻明確，兩造間其餘攻擊防禦方法及舉證，經本
23 院審酌後，對本件判決結果不生影響，爰不一一論述，併此
24 敘明。

25 陸、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條、第79條。

26 中 華 民 國 111 年 3 月 31 日
27 民事第一庭 法 官 蕭淳尹

28 以上正本係照原本作成

29 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

30 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

31 中 華 民 國 111 年 3 月 31 日

01

書記官 鄧文琦

02 附表一

03

編號	金額（新臺幣）	利息起算日（民國）
1	33萬4,425元	107年9月1日
2	35萬9,100元	107年9月6日
3	3萬1,500元	107年9月15日
4	29萬9,250元	107年9月22日
5	3,675元	107年10月2日
6	29萬9,250元	107年10月31日
7	26萬9,325元	108年1月22日
合計	159萬6,525元	